

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成24年6月7日(2012.6.7)

【公開番号】特開2011-2390(P2011-2390A)

【公開日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-001

【出願番号】特願2009-147061(P2009-147061)

【国際特許分類】

G 01 K 1/14 (2006.01)

G 01 K 7/18 (2006.01)

【F I】

G 01 K 1/14 L

G 01 K 1/14 E

G 01 K 7/18 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年4月12日(2012.4.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 3】

従来の検査装置は、例えば図3に示すように、互いに隣接するローダ室1及びプローバ室2を備えている。ローダ室1は、複数枚のウエハWをカセット単位で収納するカセット収納部と、カセットからウエハWを一枚ずつ搬出入するウエハ搬送機構と、ウエハ搬送機構によってウエハWを搬送する間にウエハWをプリアライメントするプリアライメント機構と、を備えている。プローバ室2は、図3に示すように、ウエハWを保持しX、Y、Z及び方向で移動可能に構成されたウエハチャック3と、このウエハチャック3上のウエハWに形成された複数の電極パッドに接触する複数のプローブ4Aを有するプローブカード4と、このプローブカード4をカードホルダ(図示せず)によって固定する固定機構5と、プローブカード4とテストヘッドTとを電気的に接続する接続リング6と、を備え、制御装置の制御下でウエハWに形成された各デバイスの電気的特性検査を行なうように構成されている。尚、図3において、7はウエハチャック3と協働してウエハWとプローブカード4との位置合わせを行うアライメント機構で、7Aは上カメラ、7Bは下カメラであり、8はプローブカード4の固定機構5が装着されたヘッドプレートである。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 3】

また、第2の貫通孔13Bは、図2の(a)、(b)に示すように、第1のネジ部材15の雄ネジが貫通する小径孔13B₁と、小径孔13B₁から拡径し、第1のネジ部材15の頭部が収納される大径孔13B₂と、からなり、小径孔13B₁と大径孔13B₂の境界に第1のネジ部材15の頭部が係止される段部が形成されている。そして、小径孔13B₁は、第1のネジ部材15の雄ネジが螺合するようにチャックトップ21に形成された雌ネジに対応して形成されている。第1のネジ部材15の頭部が収められた第2の貫通孔13Bの大径孔13B₂の残余の空間には耐熱、耐寒性、耐衝撃性等に優れた樹脂、例

えば R T V (Room Temperature Vulcanizing Rubber)ゴムが充填されている。また、R T Vゴムは、固定用ブロック13の表面にコーティングされていると共に固定用ブロック13とチャックトップ21を接着している。